

プラグイン プラットフォーム パッケージ

これらのパッケージは金属とガラスで製作され、気密性及び絶縁性に優れており、プリント回路基板などに挿入実装するデュアル・イン・ライン用パッケージ(DIP)として使用されております。

主な特徴

- ・気密性： $1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下。
- ・絶縁抵抗：ベースリード線間DC500Vにて1000M以上。
- ・仕上げ：Ni-Ep / Ni-Elp+Au-Ep
- ・カバー(キャップ)とセットにしても供給いたします。
- ・代表的概要図を以下に示しておりますが、特注(カスタム)の設計・製作も致しますので、別途ご相談ください。



デュアル・イン・ライン用パッケージ

代表的製品の概略図

